



2024年9月30日

各位

会社名 株式会社岡本工作機械製作所  
代表者名 代表取締役社長 石井 常路  
(コード番号 6125 東証 スタンダード市場)  
問合せ先 取締役常務執行役員  
管理本部長 高橋 正弥  
(TEL. 027-385-5800)

## 不動産の購入（固定資産の取得）に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、下記固定資産を取得することを決議し、不動産の購入契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取得理由

当社は長期戦略「ビジョン 2030」を策定し、『世界に類のない「総合砥粒加工機メーカー」として、平面研削盤・半導体ウェハ研磨装置でグローバルNo. 1を目指す』ことを長期ビジョンとして掲げております。長期ビジョンの柱としては、特に半導体関連装置事業を主力セグメントに位置付けております。半導体市場は、通信技術の発達やIoT、AI・ディープラーニング、自動運転の本格化等を背景とした市場成長が見込まれますが、特に次世代半導体として注目される化合物半導体市場は、より一層の市場成長が予測されております。

著しい成長が見込まれる次世代半導体市場の成長を捉え、当社グループの企業価値を一層高めていくには、競合他社対比で優位性のある製品を開発するための技術開発棟及び顧客に対し製品の魅力を訴求するためのショールームの設備が必要であります。

本件不動産購入により、研究開発の段階において技術進歩の早い業界の中で顧客方針を見極め応え続けること、設計段階において高精度・安定稼働を両立する設計の実現をすること、販売段階において顧客のニーズに応じたソリューションの提案を行い、顧客側の生産活動の円滑化を図るサポート体制を整えることを目的とし、半導体関連装置の技術開発棟及びショールームに係る固定資産を取得することといたしました。

#### 2. 取得資産の内容

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| (1) 所在地   | 埼玉県さいたま市              |
| (2) 取得価格  | 700百万円※               |
| (3) 資産の概要 | 半導体関連装置の技術開発棟及びショールーム |

※取得価格は直前連結会計年度の末日における連結純資産の30%未満であります。

#### 3. 相手先の概要

相手先は一事業法人であります。当該相手先につきましては、相手先の意向により非開示とさせていただきます。また、当社と相手先との間に、記載すべき資本関係、人的関係及び取引関係はなく、関連当事者には該当しません。

#### 4. 取得の日程

|              |                  |
|--------------|------------------|
| (1) 契約締結日    | 2024年9月30日       |
| (2) 設備搬出予定期間 | 2024年10月～2025年3月 |
| (3) 引き渡し予定   | 2025年3月末予定       |

#### 5. 固定資産の取得に係る資金

2024年5月22日に開示いたしました「資本業務提携、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」における「Ⅱ. 第三者割当により発行される新株式の募集 3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期」の頁に記載の「①半導体関連装置及び工作機械に関連した技術開発棟の新設、ショールームの刷新のための設備資金」に該当いたします。

なお、上記2024年5月22日の開示で調達した資金9,806百万円のうち、今回の固定資産の支払いに充当する金額は700百万円であります。

ただし、当該不動産における改修工事等の諸費用が発生する見込みであり、当該費用については、調達した資金9,806百万円から充当する予定であります。

#### 6. 今後の見通し

当該固定資産の取得による、2025年3月期の業績に与える影響は軽微です。今後、業績に重要な影響を与える事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以上